



奇景光電 IT 應用 OLED 觸控 IC 正式量產 推動顯示與觸控體驗全面升級

訊號處理與演算法領先業界，兼容多種新世代 OLED 面板，實現精準觸控與低干擾顯示

【台灣台南，2026 年 2 月 4 日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（4）日宣布，領先業界的 HX85200 系列 OLED 觸控 IC，已獲多家全球領先 IT 品牌客戶採用，將產品導入高階 OLED 筆電，並於 2026 年第一季進入量產。奇景最新的 OLED 觸控 IC，內建領先業界的差動訊號處理電路與演算法，提供高精準度多指電容式觸控，並支援多種 OLED 面板架構，協助新一代 OLED 機型的筆電與平板品牌，實現更流暢的觸控操作體驗，同時維持顯示器與觸控之間的高穩定度與低干擾表現。

由於 OLED 面板比 LCD 更薄、結構堆疊更精細且更容易受到干擾，因此對觸控感測穩定性的要求更高。奇景全新的 OLED 觸控 IC 可應用於剛性、柔性、或混合式 OLED 面板架構，能有效克服來自柔性與混合式 OLED 面板的背景顯示雜訊，精準捕捉指尖觸控訊號，同時大幅降低觸控操作對 OLED 面板影像品質的干擾，確保顯示效果清晰穩定。

此外，HX85200 OLED 觸控 IC 支援不同數量的感測節點與面板尺寸，針對 138 與 118 通道兩種架構，分別對應不同尺寸 OLED 面板在觸控精準度與功耗之間的最佳化需求。其中，138 通道版本適用於 13 吋至 16 吋筆記型電腦，可支援大尺寸 OLED 面板所需的高精度、多點觸控與寬感測範圍；118 通道則適用於平板裝置，並支援 USI 與 MPP 主動筆協定，可提供精準、低延遲的筆輸入體驗。

奇景觸控與顯示事業中心執行副總邱明正表示，隨著高階 IT 設備加速導入 OLED 技術，裝置對高畫質顯示與直覺互動體驗的要求同步提升，也進一步帶動市場對更流暢且精準觸控技術的需求。在面板結構更薄、顯示環境更複雜的 OLED 架構下，觸控與顯示器之間的穩定整合已成為設計關鍵，也是決定高階裝置使用體驗與產品差異化的重要因素。奇景將持續投入新世代觸

控技術創新，並與全球品牌緊密合作，攜手推動 IT 應用中顯示與觸控整合體驗全面升級。

關於奇景光電：

奇景光電股份有限公司（納斯達克代號：HIMX）為一個專注於影像顯示處理技術之 IC 設計公司。本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品廣泛應用於電視、桌上型電腦顯示器、筆記型電腦、手機、平板電腦、汽車、電子紙裝置、工業顯示器及其他多種消費性電子產品。其中，奇景光電更是全球車用顯示器解決方案的領先創新者，車用驅動 IC 市佔率全球第一，提供完整方案包括傳統驅動 IC、先進的觸控顯示整合晶片（TDDI）、分區調光時序控制晶片（Local dimming Tcon）、車用超大尺寸觸控顯示技術（LTDI）以及 OLED 顯示器技術。奇景光電也是 tinyML 視覺人工智慧及光學相關產品領導者，其專屬的 WiseEye™ 超低功耗 AI 智慧感測，整合自家超低功耗 AI 處理器、全時（Always-On）CMOS 影像感測器，和基於 CNN 的 AI 演算法，已廣泛用於消費電子及 AIoT 物聯網等相關領域。奇景光電並率先投入繞射晶圓級光學鏡頭、矽控液晶光閥（LCoS）微型顯示器和 3D 感測解決方案的技術開發，應用於各式 AR、VR 及元宇宙等領域。此外，奇景光電也提供其他產品，包含觸控面板控制 IC、OLED IC、LED 驅動 IC、電子紙驅動 IC、電源管理 IC、CMOS 影像感測器，滿足多種顯示器需求。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為 2,200 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本、德國與美國。至 2025 年 12 月 31 日為止，奇景光電在全球已取得 2,595 項專利，尚有 364 項專利正在申請中。

<https://www.himax.com.tw/zh/company/>

奇景光電聯絡人：

刁玉苹 / Karen Tiao

投資人關係與公共關係部門主管暨發言人

hx_ir@himax.com.tw

奇景光電股份有限公司

Himax Technologies, Inc.

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2024 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司

皆無義務公開更新或修改此風險說明。